

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

- А.Дедюхин.** К нам приходят за решением измерительных задач №1, с.10
- С.Сорокин.** Если есть идеи, их нужно продвигать №2, с.10
- И.Марков.** "Совтест АТЕ": ваш партнер по качеству №2, с.145
- В.Лысов.** Из 2011 года в 2012: дисциплина и ответственность №2, с.216
- С.Лукачев.** Выбор региона для контрактного производства электроники: Россия, Китай, Европа №2, с.220
- В.Солодуха.** Не считайте нас иностранцами! №3, с.8
- А.Якунин.** Основные итоги деятельности радиоэлектронной промышленности в 2011 году №3, с.18
- Совещание руководителей предприятий радиоэлектронной промышленности России №3, с.22
- А.Акулин.** Заказчики от нас не уходят №3, с.137
- С.Лукачев.** А нужно ли свое производство? №3, с.144
- Сианян Ин.** Для нас качество превыше всего №4, с.8
- Дейв Айкл, Ричард Стори, Георгий Кон.** RF Micro Devices: от высоконадежных СВЧ-компонентов до услуг фаундри №4, с.14
- А.Котовиц.** Думать должна машина, а не оператор! №4, с.137
- Ю.Гуляев.** Электроника – это фундаментальная наука №5, с.8
- Н.Василенков.** Надежная работа технических средств в реальных условиях: как ее обеспечить? №5, с.16
- Патрик де Вит.** YAMAHA – "новый" бренд на рынке высокопроизводительных автоматов №5, с.153
- А.Песляк.** Мы ориентированы на инженеров №6, с.12
- М.Поляничко.** Нам интересны сложные заказы №6, с.153
- А.Якунин.** Состояние и перспективы развития отечественной микроэлектроники №7, с.10
- И.Шахнович.** Состояние и перспективы развития отечественной микроэлектроники. 11-я отраслевая научно-практическая конференция №7, с.20
- А.Калмыков.** Мы растем вместе с нашими заказчиками №7, с.161
- И.Янк.** Agrow Electronics: великий неизвестный выходит из тени №8, с.8
- Л.Соркин.** Мы смотрим на Россию не только как на рынок №8, с.16

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

- Какие выставки в области электроники в России нужны профессиональному сообществу №1, с.22
- Контрафакт и как ему противостоять №2, с.28
- Выставки – какие они есть и какими будут №2, с.32
- "Охота за головами" – зло или благо? №3, с.32
- Образование – не значит знание? О качестве подготовки специалистов в области электроники №4, с.20
- Разработчик и государство. Ждать, надеяться, верить? ... №5, с.30
- Производство российское и производство выгодное. Возможен ли знак равенства? №6, с.30

- Государственная программа – поддержка или костыли? №7, с.38
- Россия в ВТО. Что будет с электронной промышленностью? №8, с.30

НОВОСТИ

- №1, с.28; №2, с.36; №3, с.38; №4, с.26; №5, с.22; №6, с.24; №7, с.32; №8, с.22

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ЭЛЕКТРОНИКИ

- М.Шейкин.** Две микросхемы – хорошо, а одна лучше. Программируемые цифровые микросхемы с аналоговым интерфейсом №1, с.34
- И.Туркин, В.Сокольский.** Высокочастотные контактно-измерительные приспособления. Контроль частотных характеристик ПАВ-фильтров №1, с.44
- Н.Елисеёв, Г.Сычев.** Системы аналогово-цифровой обработки AD760х: многоканальность и развитая периферия №1, с.52
- М.Вуд, Д.Кулон, Л.Джиоваччини, Ю.Фада.** АЦП с синхронизацией выходных цифровых потоков. Новое решение компании NXP №1, с.56
- Павел Чуприна.** Современные ЦАП и АЦП с низким энергопотреблением компании Maxim – отличные решения для миниатюрных систем различного назначения №1, с.60
- К.Джуринский.** Новые имена на российском рынке помехоподавляющих фильтров. Часть 1. Фильтры военного назначения корпорации AVX №2, с.44
- Павел Чуприна.** Современные датчики компании Maxim для различных применений №2, с.54
- В.Никитин, Р.Белов, Э.Семенов, Е.Данилов.** Полуморфные переключатели. Новый тип коммутационных элементов для космических и авиационных аппаратов ... №2, с.62
- А.Багдасарян, Т.Синицына, П.Орлов, В.Швец.** Частотно-селективные СВЧ-модули на основе преобразователей веерного типа №2, с.66
- А.Борисов, А.Любимов, В.Тимкин.** Плоские электромагнитные компоненты на фольгированном полиимиде – малые габариты, отличные характеристики №2, с.72
- М.Красильщиков, В.Смирнов, А.Шалаева.** Влияние постоянного напряжения на параметры керамических конденсаторов. О чем не пишут в документации №2, с.76
- В.Лебедев.** Инновационная стратегия развития ОАО "Элеконд" №2, с.84
- Б.Финк, М.Скараззати.** Микроконтроллеры на базе ядра Cortex-M0: эффективное решение для промышленности №3, с.96
- К.Джуринский.** Новые имена на российском рынке помехоподавляющих фильтров. Часть 2. Фильтры компании SOURIAU PA&E №3, с.100

А.Бекмачев. Датчики газа e2v. Есть решение для любой задачи	№3, с.108
Павел Чуприна. Силовая электроника, источники вторичного питания, схемы управления. Новые высокоэффективные решения компании Maxim	№4, с.60
И.Романова. Продукция силовой электроники компании Vishay на российском рынке	№4, с.66
С.Ефименко, А.Турцевич, А.Белоус. Микросхемы импульсных понижающих стабилизаторов производства ОАО "ИНТЕГРАЛ"	№4, с.74
М.Гольцова. Мощные GaN-транзисторы. Истинно революционная технология	№4, с.86
Л.Борисов, Г.Щелкунов. Мощные и сверхмощные СВЧ-источники: от клистронов до нового класса приборов	№4, с.102
Микроконтроллеры и приемопередатчики компании Energy Micro – преимущества и применение	№4, с.108
Т.Эндрюс. RamtRon: трудности позади	№5, с.38
В.Майская. МЭМС рынок. Стойкий продолжительный рост	№5, с.42
И.Романова. Магнитные датчики компаний NXP, Honeywell и Murata на российском рынке	№5, с.56
Н.Елисеев, И.Яковлев. Новые датчики компании Honeywell: два в одном	№5, с.68
И.Кокорева. Датчики освещенности и приближения компании Maxim. Новая продукция	№5, с.72
А.Позднякова. Новые решения компании NXP: датчик светодиодной подсветки салона автомобиля и усилитель GPS-сигнала	№5, с.80
И.Ли. Магнетроны импульсного действия – все дело в катоде	№5, с.84
А.Бекмачев, К.Солинский. Датчики Meggitt. 150 лет в экстремальных условиях	№5, с.90
В.Шарапов, Ж.Сотула. Пьезоэлектрические преобразователи. Новые технологии проектирования	№5, с.96
Денни Биран. "Конвергенция кремния" и будущее системного проектирования	№5, с.104
В.Хадден. ИС для заряда Li-Ion-аккумуляторов – как сделать правильный выбор	№6, с.108
А.Самодолов, М.Шейкин. Промышленные USB-соединители TE connectivity. Решения для жестких условий эксплуатации	№6, с.114
А.Ченакин. Задуманное превратилось в реальность	№7, с.44
Н.Елисеев. GSM-модули: области применения и производители	№7, с.50
И.Викулов. Монолитные интегральные схемы СВЧ – технологическая основа АФАР	№7, с.60
А.Багдасарян, С.Багдасарян, В.Бутенко, Г.Карапетьян. Радиочастотные метки на ПАВ. Особенности конструкции и технологии	№7, с.76

А.Иванов. Коммутаторы для сетей Ethernet с особо жесткими условиями эксплуатации	№7, с.84
А.Иванов. RF Serial Bridge. Беспроводной удлинитель/конвертор последовательных интерфейсов	№7, с.88
Д.Данг. Память FRAM – новые возможности беспроводных приложений.....	№8, с.64
Д.Зотов. Соединители серии RJ Field – высокая надежность в жестких условиях эксплуатации	№8, с.68
К.Джуринский. К вопросу об отечественной и импортной элементной базе. Ответ на письмо сотрудников ОАО "Гириконд"	№8, с.72

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

М.Гольцова. "Яркое" будущее светодиодной технологии. Международная выставка и конференция Lightfair International	№6, с.38
И.Романова. Органические светодиоды. Новые материалы, новые технологии	№6, с.50
Павел Чуприна. Драйверы светодиодов компании MAXIM. Новые решения	№6, с.58

СХЕМОТЕХНИКА

А.Ченакин. ГУН или ЖИГ? Проблема выбора при проектировании высококачественного синтезатора с ФАПЧ	№6, с.118
--	-----------

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

М.Шейкин. Мало мощности – много возможностей. Обзор рынка маломощных источников питания	№4, с.32
Е.Рабинович. Источники питания EFE компании TDK-Lambda – компактные и надежные	№4, с.44
М.Никитин. Интеллектуальные системы электропитания – решения компании Deutronic	№4, с.50
Е.Рабинович. Программируемые источники питания Z+. Новое поколение, широкие возможности	№7, с.92

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

Й.-Х.Бредерс. Интерфейсная микросхема ADAS1000. Оптимальное решение для приборов ЭКГ	№1, с.70
---	----------

ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

Ю.Носов, А.Сметанов. Страсти по лазеру	№8, с.130
---	-----------

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЯ

Е.Николаев. X-параметры – эффективный инструмент для анализа электрических цепей	№1, с.76
А.Шиганов. SiGe-технология для высокоскоростных осциллографов LeCroy	№1, с.80
С.Гудков. Система для испытаний источников питания ATE 8000: универсальность и эффективность	№2, с.112
И.Николаев. Новые импульсные источники питания АК ИП:	

удобство использования и многофункциональность	№2, с.116
А.Иванов. Пакет JTAG ProVision. Разработка приложений периферийного сканирования	№2, с.120
С.Корнеев. Шумы осциллографа: как с ними бороться?	№3, с.112
С.Корнеев. Анализатор спектра GSP-7930 – компактный и многофункциональный	№4, с.116
М.Фрейдхоф, Г.Шульце. Осциллографы компании Rohde & Schwarz: преимущества цифровой системы запуска	№5, с.110
И.Николаев. Цифровые осциллографы LeCroy WaveAce – пополнение в семействе	№5, с.118
Э.Друкер. Системы ФАПЧ в синтезаторах частоты. Методы снижения шумов и паразитных сигналов	№6, с.126
М.Лаутербах. Тестирование медицинского оборудования – решения компании LeCroy	№6, с.132
Д.Серков. Электронные нагрузки АКИП – эффективный инструмент тестирования LED-драйверов	№7, с.98
С.Корнеев. Осциллографы HDO4000 и HDO6000 – высокое разрешение и широкие возможности	№8, с.106

НОВИНКИ КОМПАНИИ AGILENT

№1, с.84; №2, с.118; №3, с.118; №4, с.124; №5, с.122; №6, с.123; №7, с.102; №8, с.110

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Секвойя: империя наносит ответный удар. Опубликована 39-я редакция TOP500	№5, с.88
М.Шурыгина. Инновации на уровне ядра. Энергоэффективные процессорные архитектуры	№8, с.34
И.Романова. Компания NXP расширяет семейство микроконтроллеров LPC4000	№8, с.52
Ю.Сахно, М.Павлюк, М.Какоулин. Микроконтроллер K1986BE21Y компании "Миландр" для счетчиков электроэнергии	№8, с.56
"Ягуар" становится "Титаном": опубликована 40-я редакция TOP-500	№8, с.60

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В.Плебанович, Л.Сятковский, С.Воронин. Фотолитография. Решение проблемы прецизионного совмещения слоев после эпитаксии	№1, с.100
Д.Евдокимов, В.Киреев, А.Мельников, Д.Челапкин, Е.Назаров. Травление пленок париленов в системах низкого давления с плазмой высокой плотности	№1, с.104
А.Нисан. Гибкие печатные экраны. Разновидности и технологии производства	№2, с.128
В.Юдинцев. Пост-КМОП структуры	№3, с.48
А.Васильев, Е.Борисов. Производство МЭМС. Перспективы и решения	№3, с.60

А.Максимов. Металлокерамические корпуса компании "Тестприбор" – прибавление в семействе	№3, с.66
А.Алексеев, Д.Русов, О.Хаит. Лазерное внутриобъемное скрайбирование – эффективная технология для светодиодов	№3, с.70
А.Нисан. Перспективы развития органических и печатных компонентов. По материалам Ассоциации органической электроники	№4, с.126
А.Нисан. Гибкие печатные батарейки и аккумуляторы. Технологии и перспективы развития	№7, с.146
Л.Мироненко, В.Юдинцев. Повышение радиационной стойкости интегральных схем. Конструктивные методы на базе промышленной технологии	№8, с.74
Н.Павлов. Прототип изделия за полчаса – возможности современной печатной электроники	№8, с.90

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Е.Рабинович. DC-DC-преобразователи компании TDK-Lambda: тряски не боятся	№2, с.102
---	-----------

СВЯЗЬ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

С.Дингес, Е.Хасьянова. Многолучевые антенны: решения компании ETI	№2, с.106
Жоюю Пи, Фарук Хан. Введение в широкополосные системы связи миллиметрового диапазона	№3, с.86

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

С.Попов, Ю.Попов. САПР TороR 5.3. Новые возможности .	№2, с.138
Д.Моррис. Моделирование электромагнитных полей – как выбрать лучший метод	№3, с.124
Р.Руис. Создание тестопригодных схем при проектировании SoC. Интегрированный подход	№3, с.130
А.Прикота. Схемотехническое моделирование в SimOne. Высокая скорость, высокая точность	№6, с.138
В.Джиган. Адаптивные фильтры. Современные средства моделирования и примеры реализации	№7, с.106
Дж.Янг, Б.Макхесни. Оптимизация процессорных ядер. Проверка в реальных условиях	№7, с.126
Г.Эллэн. Системы с DDR SDRAM – обеспечение баланса производительности и энергопотребления	№8, с.112
А.Сабунин. Новые возможности Altium Designer. Почему нужно забыть P-CAD?	№8, с.116

СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В.Беляев. Российское отделение Международного дисплейного общества. Юбилей. Итоги. Перспективы ..	№3, с.120
А.Андреев, И.Компанец. Жидкокристаллические дисплеи. Перспективы развития. Часть I	№6, с.72
О.Костина, В.Белецкий. OLED-дисплеи Futaba – гибкие и прозрачные	№6, с.90
В.Беляев. Международному дисплейному	

обществу (SID) – 50 лет!	№6, с.94
О.Игнатова. Оценка характеристик систем отображения.	
Методы центра управления полетами	№6, с.102
А.Андреев, И.Компанец. Жидкокристаллические дисплеи.	
Возможные применения СЖК. Часть 2	№7, с.140

ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

А.Сабунин. Организация единой базы данных ЭРИ.	
Пример работы с Altium Designer	№5, с.160
Г.Джонсон. Защитные проводники на печатной плате. Нужны ли они?	№5, с.166
А.Сергеев. Cadence Allegro PCB SI. Предтопологический анализ целостности сигналов	№6 с.162
А.Акулин. САПР печатных плат Cadence Allegro 16.6. Новые возможности	№7, с.180
С.Топоров. Экспорт Gerber- и Excellon-файлов из P-CAD. Автоматизация процесса	№7, с.186

ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ. ОБОРУДОВАНИЕ

Е.Матов. Гибкость или производительность? Компромисс больше не нужен!	№2, с.180
Д.Митичев. Истина, рожденная в мелочах. Новая серия автоматов HITACHI SIGMA	№2, с.184
А.Василенко. Производство под ключ – эффективный вариант реализации электронного производства	№7, с.172

ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ. ТЕХНОЛОГИИ

А.Нисан. Стандарты IPC по проектированию и сборке плат с компонентами с контактными площадками на нижней стороне корпуса	№1, с.88
С.Федоров, В.Бекетов. Обеспечение надежности электронных блоков при эксплуатации в условиях высоких вибрационных нагрузок	№2, с.192
А.Медведев, Г.Мылов. Развитие технологий элементов электрических межсоединений в электронных системах	№2, с.196
А.Леонов. Дефект пайки – поднятие компонента. Как избежать его или уменьшить?	№2, с.208
А.Маурин. 25 лет SMT Maschinel – история успеха продолжается	№3, с.150
Е.Назаров. Возможность производства суперкомпьютеров по технологии "система на пластине"	№3, с.154
Р.Ойлер. Безвыводные SMD-корпуса компании NXP: отличные характеристики и миниатюрные размеры	№3, с.156
Е.Махлин. Проектирование без ошибок. Перечень компонентов (bom) как основа успешной разработки печатной платы	№4, с.140
Е.Назаров. Поверхностный монтаж. Бескорпусные кристаллы ИС и корпусированные микросхемы на пластичных основаниях	№5, с.144

В.Ланин, Н.Игнатович. Пластиковые карты и технологии их производства	№5, с.148
А.Макарова. Трехмерная печать межсоединений. Плотность, плотность и еще раз плотность	№5, с.172
В.Черных, С.Чигиринский. Направления развития изделий из специальной керамики для производства электронной техники в России	№5, с.176
А.Гаранин. Критерии выбора установки рентгеновского контроля: необходимо и достаточно	№6 с.170
А.Медведев. Перспективы развития технологий электрических межсоединений в электронном приборостроении	№6, с.178
В.Ланин, Э.Шпилевский, В.Хотькин. Модификация структуры бессвинцовых припоев повышает качество паяных соединений	№7, с.166
С.Федоров. Микросхемы PoP. Практический опыт монтажа	№8, с.124

ЭКОНОМИКА + БИЗНЕС

Л.Бочаров. Управление перспективных исследований и разработок Министерства обороны США (DARPA): анализ деятельности	№5, с.134
В.Немудров, В.Мочкин. О неотложных мерах в микроэлектронике России	№5, с.148
А.Хохлун. Некоторые тенденции развития мировой электроники. Перспективы для российской промышленности	№6, с.146
М.Гольцова. СВЧ-технология Европы. Честолюбивые замыслы	№7, с.152
В.Майская. Амбициозные планы промышленности МЭМС. От миллионного долларового рынка к триллионному?	№8, с.100

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

М.Гольцова. Международная конференция IEDM. Самые быстрые, самые небольшие, самые необычные микросхемы	№1, с.108
С.Чапльгин. На выставке "Силовая электроника и энергетика" не было "пустых" дней	№1, с.126
М.Гольцова. Международная конференция IEDM. Самые быстрые, самые небольшие, самые необычные микросхемы. Часть II	№2, с.92
И.Шахнович. Productronica 2011 как зеркало инновационного производства электроники	№2, с.154
М.Гольцова. Конференция ISSCC	№3, с.72
М.Шейкин. Конференция "Встраиваемые технологии. Современные программные и аппаратные решения-2012"	№4, с.136
М.Гольцова. Конференция ISSCC. Кремний – основа устойчивого развития современного мира. Часть 2	№5, с.124
М.Шейкин. Технологии National Instruments в теории и на практике. По материалам научно-практической конференции	№8, с.128